



新製品 φ300mm対応 GTFR

- 300 mm対応の5軸水平多関節型クリーンロボット。
- ツインチャックを搭載することで、シングルアームでありながら、ツインアームの機能を確保。
- 300 mm対応の半導体製造装置内、EFEMのウェーハ搬送に適しています。
- 弊社従来製品のGTCRと比べて動作禁止エリア、速度制限の影響を減らしサイクルタイム向上。



φ300mm対応 SAL-HV

- 各種ウェーハに対応した200~300 mm対応アライナ。
- シリコンウェーハ、シリコンウェーハBGテープ(乳白色)付、透明、半透明ウェーハなどウェーハ材質に影響を受けずにセンタリングとオリフラ・ノッチを高速、高精度に位置決め。
- 独自開発のイメージセンサを使用し、モータドライバ、コントローラを本体に内蔵。
- ウェーハサイズ、材質にあわせて保持方法の変更可能。



φ300mm対応 25枚バッチ搬送ロボット KHR

- 25枚のウェーハを一括して移し替え可能。
- 一括搬送の為、移し替え時間の大幅短縮可能。
- 回転軸搭載により複数カセットのレイアウト対応可能。
- 全軸アブソリュートエンコーダ内蔵ACサーボモータ使用。(バッテリーレス)



φ300mm対応 TAIKO™ ウェーハ搬送 MTCR

※TAIKO™は、株式会社ディスコ(DISCO Corporation)の商標または登録商標です。

- EFEMや半導体製造装置内、検査装置等のウェーハを高速に搬送することができます。
- TAIKO™ウェーハの搬送はリング部で接触、保持を行い、デバイス面の接触を抑えます。
- ランダムアクセス可能、但し対応には条件があります。
※展示機はデバイス面が100μmの反りの無いウェーハを使用しています。
- 全軸ACサーボモータを使用しているため、ウェーハ以外にもトレイ、小型のガラス基板などの高負荷ワークを高速で搬送することができます。



φ300mm対応 TAIKO™ ウェーハ対応 SAL

※TAIKO™は、株式会社ディスコ(DISCO Corporation)の商標または登録商標です。

- 半導体製造装置内、検査装置等のウェーハの位置決めを必要とする搬送に対応します。
- エッジグリップ方式を採用しウェーハリング部を保持して位置決めをおこないます。
※展示機はデバイス面が100μmの反りの無いウェーハを使用しています。



参考出展 ワイヤレスティーチング

- スマートフォンやタブレットPCで操作して、ロボットを動作させることができます。
- アーム伸縮、旋回動作をジャイロ機能を用いて、感覚的な操作をさせることもできます。

※写真はイメージです。実際の製品と異なる場合があります。